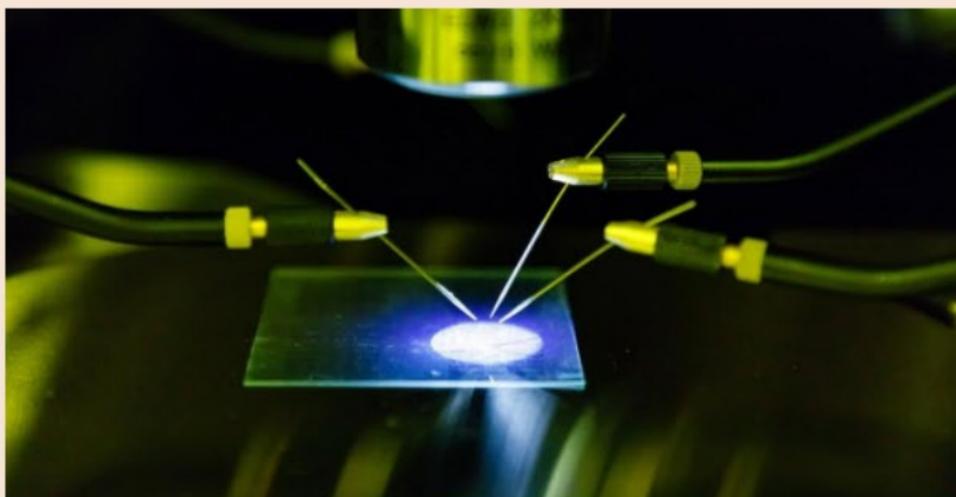


L'elettronica stampabile di Fleep Technologies chiude seed round da 900mila euro

Nello spinoff dell'Iit attiva nell'elettronica basata su polimeri riciclabili entra Eureka Ventures Sgr

di Guido Romeo



2' di lettura

L'elettronica stampabile di nuova generazione batte moneta. Fleep Technologies, lo spinoff dell'Istituto Italiano di Tecnologia dedicata alla "printed electronics", ha chiuso il suo primo *seed round* da 900mila euro con l'ingresso di Eureka Ventures Sgr tra i suoi investitori attraverso il fondo Eureka! Fund I – Technology Transfer.

La tecnologia di Fleep Technologies, guidata da Giorgio Dell'Erba, Ceo e co-fondatore insieme a Paolo Colpani e Mario Caironi (tutti provenienti dall'Iit) permette di realizzare un'elettronica basata non sul silicio ma su polimeri a base carbonio biocompatibili e riciclabili. In questo modo è possibile avere circuiti elettronici flessibili e adattabili a qualsiasi superficie, prodotti mediante tecniche di stampa tradizionali, come il rotocalco, la serigrafia o la stampa a getto di inchiostro, su diversi materiali quali plastica, carta e tessuti.

«La chiusura di questo round – osserva Giorgio Dell'Erba - ci permetterà di migliorare la tecnologia, portandola ad elevatissimi livelli di performance e solidità, in vista di un successivo sviluppo su scala industriale. Ciò che ci portiamo dietro da questo *fundraising* è la consapevolezza che anche in Italia ci sono investitori attenti alle tecnologie emergenti, seppur lontane dalla commercializzazione, che hanno voglia di investire e rischiare insieme al *founding team* puntando sulla co-creazione di valore».

La startup, lanciata nel 2018, contava già tra i *founder* il Club degli Investitori, la famiglia Cogliati, Iag, Pariter e l'azienda di elettronica Elemasterad per 800mila euro. L'ingresso di Eureka!, che ha registrato il primo *closing* in tempi record a fine luglio scorso e ha già investito in Phononic Vibes e Wise, completa un finanziamento relativamente piccolo, ma propedeutico ad un prossimo Round A di 5 milioni di euro, che il fondo ha già programmato per il 2021.

Il mercato dell'elettronica stampabile è in piena esplosione (anche a causa del Covid che rallenta lo scale-up dei sistemi tradizionali in Cina) e dai 7,8 miliardi del 2020 si stima possa superare i 20 miliardi entro il 2025.

L'interesse degli investitori per Fleep si inserisce perciò in un macro-trend di trasferimento tecnologico che trova diverse conferme a livello nazionale con i 500 milioni di euro stanziati dal governo attraverso la neo costituita Fondazione Enea Tech (alla cui presidenza guarda caso è andata Anna Tampieri, ricercatrice del Cnr nell'ambito materiali) e i 150 milioni di euro allocati da Cdp Venture sul fondo di fondi dedicato ora guidato da Claudia Pingue, ex-responsabile del Polihub del Politecnico di Milano.

«L'innovazione nei materiali è la sfida dei prossimi anni – sottolinea Stefano Peroncini, Ceo di Eureka! Venture Sgr - poiché impatta tutti i settori industriali e innumerevoli applicazioni. Una caratteristica intrinseca di queste innovazioni è poi la portabilità da un settore a un altro, come ad esempio l'impiego delle tecnologie di Fleep che trovano utilizzi innovativi nel packaging come nel farmaceutico o nell'abbigliamento».